第９回　Additive Manufacturing Symposium

主催：東京大学生産技術研究所　付加製造科学研究室

共催：株式会社アスペクト　株式会社エリジオン、

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

　　　　　　　　一般財団法人製造科学技術センター

SIP／革新的設計生産技術「Additive Manufacturingを核とした新しい

ものづくり創出 (MIAMI)」プロジェクト公開シンポジウム

及び

第９回　AM (Additive Manufacturing) シンポジウム

開催趣旨：

2012年頃から始まった3Dプリンターブームですが、徐々に製品製造に向けた検討が始まっており、それにつれて、工法や装置開発のほかにも、CADやシミュレーションなどのAM技術をどのように利用するかといったことに議論が高まっております。

本シンポジウムは1/24（木）と25（金）の2日構成として、1日目はSIP（MIAMI）プロジェクトの成果等ご報告と最先端医療のＡＭ活用に関する最前線、2日目の第９回 AM (Additive Manufacturing) シンポジウムでは、招待講演にくわえ，➀スーパーエンジニアリングプラスチック素材へのシフト、②セラミックスへの展開、③様々なビジネス展開を題材に最新の技術や動向のご報告を計画しております。

光造形はさまざまなAM技術の中で最初に商業化された技術です。1990年代、光造形は微細性にすぐれ透明な構造物ができることから、模型の製造に盛んに使われており、日本国内に大小5社以上のメーカーがあり､　日本はAMの先進国でした。その後，熱可塑性樹脂や金属など、材料特性が安定し、機械特性の得られる材料に注目の中心が移ってきました。昨今、Carbon3Dなど、最終製品の製造技術として光造形を利用しようとする動きが高まり、光造形への興味が再びもどってまいりました。そこで今回は、日本の光造形の黎明期から携わってこられた萩原恒夫氏（横浜国立大学連携研究員）に光造形をはじめとする光硬化性樹脂を用いたAM技術の可能性についてお話を伺います。

第９回　AM (Additive Manufacturing) シンポジウム　第一部

開催日時： 2019年1月24日（木）　10:00～17:30　（受付9:30から）

開催場所： 東京大学　生産技術研究所　An棟（コンベンションホール）

http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/

参 加 費： 無料（会場の都合により事前登録制）

申込締切： 2019年1月22日（火）必着（定員に達し次第締め切らせて頂きます）

募集人員：　200名

プログラム：

午前　MIAMIプロジェクト公開シンポジウム

司会　製造科学技術センター　間野　隆久

10:00 開会のご挨拶 東京大学　新野　俊樹

10:10 パラリンピックアスリートのための高性能義足の開発 東京大学　山中　俊治

10:50 義足ソケット設計CADシステムの開発 ㈱エリジオン　河野　功

11:30 ハイパフォーマンススーパーエンプラの低温造形 東京大学　新野　俊樹

12:10 総評 内閣府SIP革新的設計生産技術プログラムディレクター　佐々木　直哉

昼食・休憩　(12:20～14:00)

午後　AMの医療・福祉への活用

 司会　東京大学　新野　俊樹

14:00 整形外科における積層造形インプラントの現状と展望 京都大学　藤林　俊介

14:50 歯科補綴への応用　　　　　　　　㈱SDL・HD 札幌デンタルラボラトリー　垂水　良悦

15:40 義肢装具への応用 (公財)鉄道弘済会　義肢装具サポートセンター　臼井　二美男

16:30 クロージングリマーク ㈱アスペクト　常務取締役　萩原　正

以　上

第９回　AM (Additive Manufacturing) シンポジウム　第二部

開催日時： 2019年1月25日（金）　10:00～17:20　（受付 9:30から）

開催場所： 東京大学生産技術研究所　An棟　コンベンションホール

参 加 費： 無料（会場の都合により事前登録制）

申込締切：　 2019年1月22日（火）必着（定員に達し次第締め切らせて頂きます）

募集人員： 200名（懇親会にご参加の場合、会費として事前に5,000円を頂戴致します。）

プログラム：

 司会　東京大学　新野　俊樹

招待講演

10:00 ご挨拶 東京大学生産技術研究所　所長　岸 利治

10:10 【招待講演】光硬化性樹脂を用いた3Dプリンティングの最近の進歩

 横浜国立大学　連携研究員　萩原 恒夫

10:40 海外情報 東京大学　新野 俊樹

昼食・休憩　12:10～14:00

ハイパフォーマンスプラスチックの加工

14:00 スーパーエンジニアリングプラスチックの活用 東京大学　新野 俊樹

14:15 PPSの展開（仮） 東レ㈱　渡邊　圭

14:40 PEEKの展開（仮） ダイセル・エボニック㈱　澤田 克己

15:05 フッ素樹脂の展開（仮） ダイキン工業㈱　小森 洋和

休憩　15:30～15:45

無機材料（金属・セラミックス）の間接加工

15:45 無機材料の間接加工の概要 東京大学　新野 俊樹

16:10 セラミックスの活用(仮) 新東工業㈱　梶田 浩二

16:35 金属の間接加工 丸紅情報システムズ㈱　丸岡 弘幸

ビジネス展開

17:00 AMのビジネス事例(仮) マテリアライズジャパン㈱　小林 貞人

17:25 クロージングリマーク 東京大学　新野 俊樹

懇談会　17:30～19:30

場所：コンベンションホールホワイエ

会費:5,000円/人

以上

注：講演者、講演内容は、都合により変更になる場合がございます。

　　詳細は、ホームページでご確認下さい。

　　懇親会費は、原則、事前（事後でも構いません）に銀行振込み支払いでお願い致します。

　　（大変恐縮ですが振込手数料は、お振込先でご負担をお願い申し上げます）

必要に応じて、お申込み（振込）後、請求書（領収書）を発行いたします。

当件における連絡先：

一般財団法人製造科学技術センター　調査研究部　藤井（フジイ）、間野（マノ）

〒105-0001　東京都港区新橋３丁目４番１０号　新橋企画ビルディング４階

ＴＥＬ　０３－３５００－４８９１　ＦＡＸ　０３－３５００－４８９５

e-mail：manoアットmstc.or.jp(カタカナを@にして下さい)

*製造科学技術センター　ホームページアドレス：*[*http://www.mstc.or.jp*](http://www.mstc.or.jp)

東京大学　生産技術研究所　会場案内図



詳細は、以下のキャンパスマップをご参照ください。

<http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_04_09_j.html>

送付先：amsympo@iis.u-tokyo.ac.jp　　締切：平成３１年１月２２日（火）１７時まで

ご氏名：

組織名：

所属：

役職：

住所：

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

e-mail：

（e-mailは、到着・返信の重要な連絡先となりますので、明瞭にお書きください。また、小文字、大文字の区別も明確にお願い致します）

懇親会（１月２５日（金））　　　　　　　　参加　　　・　　　不参加　　（不要な方をお消し下さい）

注：参加費：懇親会参加費　５，０００円（消費税込）

懇親会参加の場合（事前登録、支払期日、各開催日まで（後日でも可）となっております）

請求書（レセプション／懇親会参加者全員に、参加組織名等でお送り致します）

（参加組織外での請求書の宛名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支払期日：平成３１年　　月　　　日（　）支払予定（予定が変わる場合には御連絡ください）

（本年度内のお支払いをお願い申し上げます。ご参加表明、ご入金後の返金はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願い申し上げます。当日空きがあればお申し込みを受け付けますが、事前登録で定員に達した場合はご遠慮頂く場合もございます）

領収書　　　　　　　　有り　　　・　　　無し　（不要な方をお消し下さい）

（領収書は、シンポジウム当日にお渡し致します）

**注：参加申込み順に平成３１年１月１８日以降から順次登録票（懇親会参加者は請求書）をメールで送付いたします。もし、１月２３日（水）までに何の連絡もない場合はお手数ですが、上述の（参加、懇談会登録等に関するお問合せ先）までご一報ください。**

備考（その他何かご疑問点、要求等ございましたらご自由に記載して下さい。）：

（同内容をテキストでメールに記入しお送り頂いても構いません）